

ハードウェアセキュリティ (HWS) 研究会 【開催案内】

【概要】

日時：2017年09月15日(金) 15:00-18:05

会場：東京大学生産技術研究所 会議室 TBD

住所：東京都目黒区駒場4-6-1

最寄り駅：小田急線 東北沢/代々木上原、京王井の頭線 駒場東大前/池ノ上

会場案内図：<https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/ja/access/>

主催：一般社団法人 電子情報通信学会 ハードウェアセキュリティ特別研究専門委員会

研究会参加費：無料

懇親会：18:30-@TBD (後日詳細公開・領収書発行可)

【発表申込】

募集要項：ハードウェアセキュリティ技術全般のご発表 (既発表・公開か否かを問わず)

発表申込締切：2017年09月01日(金) 23:59(日本時間)

申込方法：下記 Web ページよりお申し込みください (題目、著者、所属、アブストラクト等)

[URL] <http://www.ieice.org/ken/program/index.php?tgid=IEICE-HWS>

講演時間：20分+質疑5分

※発表申し込み多数の場合は受付順に幹事団および担当にて選定いたします。

※論文投稿受付は行わないため研究技報にも掲載はされません。公開を希望する際はご相談ください。

【問い合わせ】

研究会担当：国井 (セコム株式会社) : h-kuni@secom.co.jp